

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 01347)

新闻稿

二零二五年第一季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。
本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2025 年 5 月 8 日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二五年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零二五年第一季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 5.409 亿美元，同比增长 17.6%，环比增长 0.3%。
- 毛利率 9.2%，同比上升 2.8 个百分点，环比下降 2.2 个百分点。
- 母公司拥有人应占溢利 380 万美元，上年同期为母公司拥有人应占溢利 3,180 万美元，上季度为母公司拥有人应占损失 2,520 万美元。

二零二五年第二季度指引

- 我们预计销售收入约在 5.5 亿美元至 5.7 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 7%至 9%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事白鹏博士对二零二五年第一季度业绩评论道：

“华虹半导体二零二五年第一季度销售收入为 5.41 亿美元，毛利率为 9.2%，均符合指引。整体业绩延续了二零二四年以来的趋势，销售收入稳步成长，产品结构持续优化，产能利用率保持满载。华虹制造项目的产能爬坡进度符合预期，对公司接下来的收入增长、产品组合优化及核心竞争力的提升都具有积极意义。”

白总继续表示：“市场方面，下游需求与竞争格局亦基本延续二零二四年下半年以来的走势。但随着近期国际环境和相关政策的变化，整个半导体行业在客户需求、采购成本、产业链格局等方面都会面临较大的不确定性。当此变局，华虹半导体将坚守自身定力，持续加快有效产能扩张，增强研发能力，积极开拓市场机遇，深化降本增效，精益管理可能出现的供应链扰动，在降低风险的同时提升业绩。”

电话会议公告

日期 2025 年 5 月 8 日，星期四

时间: 17:00 香港/上海时间
05:00 美国东部时间

发言人: 白鹏，总裁兼执行董事
王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播: 会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/gp3biy2m> 作在线直播
(请提前注册登记)

电话直拨: 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI51cfe11dc7f540f2af2ea9635eedb78c>

重要提示: 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放: 直播约 2 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。
https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先进 “特色 IC + Power Discrete” 的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有 “8 英寸 + 12 英寸” 先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	540,937	459,986	539,177	17.6 %	0.3 %
毛利	49,997	29,632	61,426	68.7 %	(18.6)%
毛利率	9.2 %	6.4 %	11.4 %	2.8	(2.2)
经营开支	(97,110)	(78,520)	(110,626)	23.7 %	(12.2)%
其他(损失)/收入净额	(8,294)	3,770	(40,468)	(320.0)%	(79.5)%
税前损失	(55,407)	(45,118)	(89,668)	22.8 %	(38.2)%
所得税抵免/(开支)	3,245	19,832	(6,596)	(83.6)%	(149.2)%
期内损失	(52,162)	(25,286)	(96,264)	106.3 %	(45.8)%
净利润率	(9.6)%	(5.5)%	(17.9)%	(4.1)	8.3
以下各方应占:					
母公司拥有人	3,750	31,818	(25,199)	(88.2)%	(114.9)%
非控股权益	(55,912)	(57,104)	(71,065)	(2.1)%	(21.3)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.002	0.019	(0.015)	(89.5)%	(113.3)%
摊薄	0.002	0.019	(0.015)	(89.5)%	(113.3)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,231	1,026	1,213	20.0 %	1.5 %
产能利用率 ¹	102.7 %	91.7 %	103.2 %	11.0	(0.5)
净资产收益率 ²	0.4 %	2.0 %	(1.6)%	(1.6)	2.0

二零二五年第一季度

- 销售收入 5.409 亿美元, 同比增长 17.6%, 主要得益于付运晶圆数量上升; 环比增长 0.3%。
- 毛利率 9.2%, 同比上升 2.8 个百分点, 主要得益于产能利用率提升, 部分被折旧开支上升所抵消; 环比下降 2.2 个百分点, 主要由于折旧开支上升。
- 经营开支 9,710 万美元, 同比上升 23.7%, 主要由于研发工程片开支上升; 环比下降 12.2%, 主要由于人工开支下降, 部分被研发工程片开支上升所抵消。
- 其他损失净额 830 万美元, 上年同期为其他收入净额 380 万美元, 主要由于外币汇兑损失上升及利息收入下降, 部分被政府补贴上升所抵消。其他损失净额环比下降 79.5%, 主要由于外币汇兑损失下降及政府补贴上升。
- 所得税抵免 320 万美元, 上年同期为 1,980 万美元, 主要由于代扣代缴股息税转回减少。
- 期内损失 5,220 万美元, 上年同期及上季度分别 2,530 万美元及 9,630 万美元。
- 母公司拥有人应占利润 380 万美元, 上年同期为 3,180 万美元, 上季度为母公司拥有人应占损失 2,520 万美元。
- 基本每股盈利 0.002 美元, 上年同期为 0.019 美元, 上季度为-0.015 美元。
- 净资产收益率 (年化) 0.4%, 上年同期为 2.0%, 上季度为-1.6%。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

按类别划分的 销售收入	销售收入分析				同比 千美元	同比 %
	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)		
晶圆	515,574	95.3 %	437,060	95.0 %	78,514	18.0 %
其他	25,363	4.7 %	22,926	5.0 %	2,437	10.6 %
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

■ 本季度 95.3%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

按晶圆尺寸划分的 销售收入	销售收入分析				同比 千美元	同比 %
	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)		
8 吋晶圆	231,086	42.7 %	239,950	52.2 %	(8,864)	(3.7)%
12 吋晶圆	309,851	57.3 %	220,036	47.8 %	89,815	40.8 %
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

■ 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.311 亿美元及 3.099 亿美元。

销售收入分析						
按地域划分的 销售收入	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	442,458	81.8 %	365,695	79.5 %	76,763	21.0 %
北美 ⁴	56,427	10.4 %	46,241	10.1 %	10,186	22.0 %
亚洲 ⁵	25,784	4.8 %	23,566	5.1 %	2,218	9.4 %
欧洲	15,228	2.8 %	21,739	4.7 %	(6,511)	(30.0)%
日本 ⁶	1,040	0.2 %	2,745	0.6 %	(1,705)	(62.1)%
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度来自于中国的销售收入 4.425 亿美元，占销售收入总额的 81.8%，同比增长 21.0%，主要得益于超级结、其他电源管理、闪存、通用 MOSFET、智能卡芯片及逻辑产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 5,640 万美元，同比增长 22.0%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 2,580 万美元，同比增长 9.4%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,520 万美元，同比下降 30.0%，主要由于 IGBT、智能卡芯片及通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于日本的销售收入 100 万美元，同比下降 62.1%，主要由于超级结产品的需求下降。

³ 包括中国大陆及中国香港。

⁴ 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵ 不包括中国及日本。

⁶ 包括于 2013 年由一家总部位于美国的公司所收购的一家主要日本客户。

销售收入分析						
按技术平台划分的 销售收入	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	130,290	24.1 %	119,214	25.9 %	11,076	9.3 %
独立式非易失性存储器	42,875	7.9 %	31,072	6.8 %	11,803	38.0 %
功率器件	162,751	30.1 %	143,344	31.1 %	19,407	13.5 %
逻辑及射频	66,787	12.3 %	64,213	14.0 %	2,574	4.0 %
模拟与电源管理	136,784	25.3 %	101,495	22.1 %	35,289	34.8 %
其他	1,450	0.3 %	648	0.1 %	802	123.8 %
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.303 亿美元，同比增长 9.3%，主要得益于智能卡芯片及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 4,290 万美元，同比增长 38.0%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.628 亿美元，同比增长 13.5%，主要得益于超级结及通用 MOSFET 产品需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 6,680 万美元，同比增长 4.0%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.368 亿美元，同比增长 34.8%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析						
按工艺技术节点划分的销售收入	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	124,280	23.0 %	94,477	20.6 %	29,803	31.5 %
90nm 及 95nm	128,864	23.8 %	88,516	19.2 %	40,348	45.6 %
0.11μm 及 0.13μm	54,059	10.0 %	71,430	15.5 %	(17,371)	(24.3)%
0.15μm 及 0.18μm	29,938	5.5 %	29,915	6.5 %	23	0.1 %
0.25μm	3,517	0.7 %	7,617	1.7 %	(4,100)	(53.8)%
0.35μm 及以上	200,279	37.0 %	168,031	36.5 %	32,248	19.2 %
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 1.243 亿美元，同比增长 31.5%，主要得益于闪存及逻辑产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.289 亿美元，同比增长 45.6%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入 5,410 万美元，同比下降 24.3%，主要由于智能卡芯片及 MCU 产品的需求下降。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入 2,990 万美元，同比增长 0.1%。
- 本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入 350 万美元，同比下降 53.8%，主要由于通用 MOSFET 及射频产品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入 2.003 亿美元，同比增长 19.2%，主要得益于超级结、通用 MOSFET 及智能卡芯片的需求增加。

销售收入分析						
按终端市场分布划分的销售收入	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
消费电子	348,100	64.3 %	287,863	62.6 %	60,237	20.9 %
工业及汽车	119,878	22.2 %	102,723	22.3 %	17,155	16.7 %
通信	65,264	12.1 %	61,204	13.3 %	4,060	6.6 %
计算	7,695	1.4 %	8,196	1.8 %	(501)	(6.1)%
销售收入总额	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 3.481 亿美元，占销售收入总额的 64.3%，同比增长 20.9%，主要得益于超级结、其他电源管理、闪存、通用 MOSFET 及逻辑产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.199 亿美元，同比增长 16.7%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 6,530 万美元，同比增长 6.6%，主要得益于模拟产品的需求增加。
- 本季度计算类产品销售收入 770 万美元，同比下降 6.1%。

产能 ⁷ 及产能利用率			
	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	413	391	391
总体产能利用率	102.7%	91.7%	103.2%

- 本季度末月产能 413,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 102.7%，较上季度下降 0.5 个百分点。

付运晶圆					
折合 8 吋千片晶圆	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,231	1,026	1,213	20.0 %	1.5 %

- 本季度付运晶圆 1,231,000 片，同比上升 20.0%，环比上升 1.5%。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础

经营开支分析					
以千美元计	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,214	1,985	2,617	11.5 %	(15.4)%
管理费用 ⁸	94,896	76,535	108,009	24.0 %	(12.1)%
经营开支	97,110	78,520	110,626	23.7 %	(12.2)%

- 经营开支 9,710 万美元，同比上升 23.7%，主要由于研发工程片开支上升；环比下降 12.2%，主要由于人工开支下降，部分被研发工程片开支上升所抵消。

其他(损失)/收入净额					
以千美元计	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,513	3,560	3,481	(1.3)%	0.9 %
利息收入	15,619	25,020	20,450	(37.6)%	(23.6)%
汇兑损失	(16,199)	(5,850)	(48,664)	176.9 %	(66.7)%
分占联营公司溢利/(损失)	652	1,411	(433)	(53.8)%	(250.6)%
财务费用	(23,301)	(24,585)	(20,406)	(5.2)%	14.2 %
政府补贴	11,231	3,799	4,705	195.6 %	138.7 %
其他	191	415	399	(54.0)%	(52.1)%
其他(损失)/收入净额	(8,294)	3,770	(40,468)	(320.0)%	(79.5)%

- 其他损失净额 830 万美元，上年同期为其他收入净额 380 万美元，主要由于外币汇兑损失上升及利息收入下降，部分被政府补贴上升所抵消。其他损失净额环比下降 79.5%，主要由于外币汇兑损失下降及政府补贴上升。

⁸管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计

	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	50,186	40,660	308,108	23.4 %	(83.7)%
投资活动所用现金流量净额	(494,291)	(298,951)	(1,444,013)	65.3 %	(65.8)%
融资活动所得/(用)现金流量净额	59,137	789,913	(50,929)	(92.5)%	(216.1)%
外汇汇率变动影响净额	5,771	(8,817)	(120,783)	(165.5)%	(104.8)%
现金及现金等价物变动影响净额	(379,197)	522,805	(1,307,617)	(172.5)%	(71.0)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 5,020 万美元，同比上升 23.4%，主要由于本季度客户收款增加，环比下降 83.7%，主要由于政府补助收款减少及材料和所得税付款增加。
- 投资活动所用现金流量净额 4.943 亿美元，其中包括固定资产投资支出 5.109 亿美元，部分被利息收入 1,660 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 5,910 万美元，其中提取银行借款 8.610 亿美元，及员工行权发行股份收到 1,310 万美元，部分被偿还银行借款 8.112 亿美元，支付利息 330 万美元，及支付租赁负债 50 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计

	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (已审核)
资产总额	12,286,786	12,415,108
负债总额	3,406,124	3,508,489
所有者权益总额	8,880,662	8,906,619
资产负债率 ⁹	27.7%	28.3%

资本开支

以千美元计

	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)
华虹 8 吋	14,264	21,159
华虹无锡	18,402	43,833
华虹制造	478,185	1,440,717
合计	510,851	1,505,709

- 本季度资本开支 5.109 亿美元，其中 4.782 亿美元用于华虹制造，1,840 万美元用于华虹无锡，及 1,430 万美元用于华虹 8 吋。

⁹ 资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计

	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (已审核)
发展中物业	221,061	221,905
存货	468,597	467,060
贸易应收款项及应收票据	286,763	270,461
预付款项、其他应收款项及其他资产	411,207	363,997
应收关联方款项	16,520	18,324
已冻结存款及定期存款	31,669	31,624
现金及现金等价物	4,079,935	4,459,132
流动资产总额	5,515,752	5,832,503
贸易应付款项	255,321	298,372
其他应付款项及暂估费用	759,177	880,447
计息银行借款	329,972	280,704
租赁负债	7,543	4,912
政府补助	57,700	57,563
应付关联方款项	12,724	9,125
应付所得税	18,620	31,115
流动负债总额	1,441,057	1,562,238
净营运资金	4,074,695	4,270,265
速动比率	3.3x	3.3x
流动比率	3.8x	3.7x
贸易应收款项及应收票据周转天数	46	45
存货周转天数	86	90

- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 3.640 亿美元上升至本季度末的 4.112 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 贸易应付款项由上季度末的 2.984 亿美元下降至本季度末的 2.553 亿美元，主要由于本季度支付材料款。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 8.804 亿美元下降至本季度末的 7.592 亿美元，主要由于本季度支付应付资本开支。
- 计息银行借款由上季度末的 2.807 亿美元上升至本季度末的 3.300 亿美元，主要由于一年内到期的长期银行借款增加。
- 应付所得税由上季度末的 3,110 万美元下降至本季度末的 1,860 万美元，主要由于本季度缴付所得税。
- 净营运资金 本季度末 40.747 亿美元，流动比率 3.8。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 46 天。
- 存货周转天数 86 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)
销售收入	540,937	459,986	539,177
销售成本	(490,940)	(430,354)	(477,751)
毛利	49,997	29,632	61,426
其他收入及收益	30,563	32,851	29,155
投资物业的公平值损失	-	-	(39)
销售及分销费用	(2,214)	(1,985)	(2,617)
管理费用	(94,896)	(76,535)	(108,009)
其他费用	(16,208)	(5,907)	(48,745)
财务费用	(23,301)	(24,585)	(20,406)
分占联营公司溢利/(损失)	652	1,411	(433)
税前损失	(55,407)	(45,118)	(89,668)
所得税抵免/(开支)	3,245	19,832	(6,596)
期内损失	(52,162)	(25,286)	(96,264)
以下各方应占:			
母公司拥有人	3,750	31,818	(25,199)
非控股权益	(55,912)	(57,104)	(71,065)
持有人应占每股盈利			
基本	0.002	0.019	(0.015)
摊薄	0.002	0.019	(0.015)
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,721,931,435	1,716,634,650	1,718,222,223
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,728,142,630	1,718,334,991	1,724,086,667

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (已审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	5,967,555	5,859,117	3,587,363
投资物业	209,257	164,153	166,354
使用权资产	76,359	77,761	79,347
无形资产	29,122	31,456	46,526
于联营公司的投资	140,650	139,799	140,270
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	289,722	289,311	287,089
长期预付款项	57,989	21,008	200,074
递延税项资产	380	-	501
非流动资产总额	6,771,034	6,582,605	4,507,524
流动资产			
发展中物业	221,061	221,905	194,181
存货	468,597	467,060	431,206
贸易应收款项及应收票据	286,763	270,461	306,151
预付款项、其他应收款项及其他资产	411,207	363,997	53,242
应收关联方款项	16,520	18,324	15,688
已冻结存款及定期存款	31,669	31,624	32,032
现金及现金等价物	4,079,935	4,459,132	6,107,986
流动资产总额	5,515,752	5,832,503	7,140,486
流动负债			
贸易应付款项	255,321	298,372	239,261
其他应付款项及暂估费用	759,177	880,447	379,133
计息银行借款	329,972	280,704	232,201
租赁负债	7,543	4,912	6,257
政府补助	57,700	57,563	41,643
应付关联方款项	12,724	9,125	9,704
应付所得税	18,620	31,115	59,018
流动负债总额	1,441,057	1,562,238	967,217
流动资产净额	4,074,695	4,270,265	6,173,269
总资产减流动负债	10,845,729	10,852,870	10,680,793
非流动负债			
计息银行借款	1,948,409	1,917,235	1,993,525
租赁负债	15,160	18,068	17,714
递延税项负债	1,498	10,948	2,345
非流动负债总额	1,965,067	1,946,251	2,013,584
净资产	8,880,662	8,906,619	8,667,209
权益和负债权益			
股本	4,957,182	4,938,457	4,934,028
储备	1,315,995	1,308,569	1,389,777
本公司拥有人应占权益	6,273,177	6,247,026	6,323,805
非控股权益	2,607,485	2,659,593	2,343,404
权益总额	8,880,662	8,906,619	8,667,209

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)
经营活动现金流量:			
税前亏损	(55,407)	(45,118)	(89,668)
折旧及摊销	172,126	133,088	142,306
应占联营公司(溢利)/损失	(652)	(1,411)	433
营运资金的变动及其它	(65,881)	(45,899)	255,037
经营活动所得现金流量净额	50,168	40,660	308,108
投资活动现金流量:			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(510,851)	(302,574)	(1,505,709)
收到政府对设备的补助	-	-	41,149
其他投资活动所得现金流量	16,560	3,623	20,547
投资活动所用现金流量净额	(494,291)	(298,951)	(1,444,013)
融资活动现金流量:			
提取银行贷款	860,985	103,405	84,551
发行股份所得收益	13,077	114	1,478
非控股权益资本注资	-	689,430	-
偿还银行贷款	(811,156)	-	(91,518)
已付利息	(3,252)	(2,155)	(50,498)
支付租赁负债	(517)	(881)	(401)
收到政府对财务费用的补助	-	-	5,459
融资活动所得/(用)现金流量净额	59,137	789,913	(50,929)
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(384,968)	531,622	(1,186,834)
期初现金及现金等价物	4,459,132	5,585,181	5,766,749
外汇汇率变动影响净额	5,771	(8,817)	(120,783)
期末现金及现金等价物	4,079,935	6,107,986	4,459,132

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

唐均君(董事长)

白鹏(总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂壩太平绅士

封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

唐均君

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二五年五月八日